

中国国际金融股份有限公司

关于合肥晶合集成电路股份有限公司

2024 年半年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，针对晶合集成 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）经营情况，出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与晶合集成签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2024 年上半年度晶合集成在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等	2024 年上半年度晶合集成在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解晶合集成业务情况，对晶合集成开展了持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	2024 年上半年度，保荐机构督导晶合集成及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文

序号	工作内容	持续督导情况
		件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促晶合集成依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对晶合集成的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，晶合集成的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促晶合集成依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对晶合集成的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024年上半年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2024年上半年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2024年上半年度持续督导期间内，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形	2024年上半年度持续督导期间内，晶合集成未发生左述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。

序号	工作内容	持续督导情况
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，晶合集成不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1.研发人员不足或流失风险

集成电路行业是典型的技术密集型行业，稳定、专业的研发团队是公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的基础和关键。随着集成电路企业数量的不断增长，行业竞争不断加剧，企业之间人才的争夺也更加激烈。公司高度重视人才队伍建设，采取股权激励等多种措施吸引、留住优秀技术人员，已发展和培养了一支成熟、稳定、创新能力强的核心研发团队，为公司新产品、新制程的研发和生产做出了突出贡献。但若公司优秀技术人才流失或无法继续培养或招揽，将对公司的研发生产造成较大不利影响，使公司处于市场竞争的不利地位。

2.研发进展不及预期风险

公司所处的集成电路行业具有技术含量高、研发周期长、产品更新换代迅速、市场需求变化较快等特点。为适应行业发展，满足客户需求的变动，公司坚持技术创新，在新产品、新制程的研发上持续投入大量资金与人力资源，不断推出新产品。但若公司在研发过程中的关键技术未能突破、相关性能指标未达预期、相应的特色工艺平台未能开发完成，或是未能及时将新技术运用于产品开发并实现产业化，将对公司的市场竞争力造成不利影响。

3.核心技术外泄或失密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司储备了一系列具有自主知识产权的核心技术，拥有覆盖研发及生产过程中的各个关键环节的数百项专利，同时，公司仍在持续进行多项针对主营业务的技术研发工作。公司十分重视对核心技术的保护工作，通过申请专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术进行有效保护，并制定了保密制度，对核心技术人员在保密义务、知识产权及离职后的竞业情况作出了严格规定，同时，通过对访问权限划分、敏感信息监控等方式加强网络安全管理，以保护公司的合法权益，防止核心技术外泄。但由于技术秘密保护措施的限制及其他不可控因素，公司仍存在核心技术泄密的风险。未来，公司若在经营过程中因内部管理不善、工作疏忽、外部窃取等原因导致核心技术泄密或被盗用，可能影响公司的后续技术开发能力，削弱公司的核心竞争力，影响公司的市场竞争优势。

（二）经营风险

1.客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入合计 263,399.52 万元，占营业收入的比例为 59.89%，客户集中度较高。公司目前与主要客户保持了良好的合作关系并与部分客户签署了长期框架协议，未来如果公司的主要客户因市场竞争加剧、宏观经济波动等原因生产经营出现问题，或因产品技术等原因采购战略发生较大变化，导致其向公司下达的订单数量大幅下降，且公司未能及时拓展新的客户源，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

2.新产品需求不及预期风险

公司一直重视新产品和新制程的研发工作，目前 55nm BSI 已经进入量产阶段，40nm 高压 OLED 显示驱动芯片已实现小批量生产，28nm OLED 技术工艺的开发正在稳步推进中，新产品陆续研发完成并通过认证及量产，将会给公司经营业绩带来新的增长点。但新产品能否快速导入及放量取决于公司的市场拓展能力、客户需求等多种因素，公司存在新产品需求不及预期的风险。

3.公司产品结构相对单一的风险

公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务，目前的主要产品包括 DDIC、CIS、PMIC、

MCU 和 Logic，其中 DDIC 的销售收入占主营业务收入的比例较高。虽然公司正在进行 CIS、PMIC、MCU 和 Logic 等其他技术平台的研发及扩产工作，并积极进行市场推广，但在短期内，如果面板显示驱动芯片市场需求发生较大波动，公司在该领域的生产或销售出现不利变化，则可能对公司的现金流、盈利能力产生不利影响。

4.公司无法及时消化新增产能的风险

2024 年公司计划扩产 3-5 万片/月，制程节点主要涵盖 55nm、40nm，且将以高阶 CIS 为扩产主要方向。上述项目建成后公司产能规模将相应扩大，有助于提升公司满足市场需求的能力；同时，公司将进一步开拓新客户、拓展销售渠道，充分消化新增产能以提升公司经营业绩。若未来市场需求发生重大不利变化、下游市场增速不及预期、公司核心客户需求增长不及预期或无法继续覆盖核心客户、其他同行业参与者纷纷加速扩产导致供需市场变化等情形，公司将面临产品销售无法达到预期目标致使无法及时消化新增产能的风险，则可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

1.外汇汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售及境外采购的情况，并主要通过美元或日元进行结算，公司相应持有美元等外币货币性资产。虽然公司在业务开展时已考虑了订单签订及款项收付期间汇率可能产生的波动，也持续平衡外币货币性资产规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响，但难以预测境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素可能对人民币与外币汇率产生的影响，若未来人民币与外币之间的汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来经营业绩的稳定造成不利影响。

2.毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率为 24.43%。公司综合毛利率受产品结构、市场供求关系、公司议价能力、技术先进性、市场销售策略等因素的影响。此外，公司成本结构中以固定性成本为主，主要包含厂房、设备折旧等，价格、稼动率对毛利率影响较大。未来，如果受产业周期波动影响，市场需求不足，将影响产品销量及价格，可能导致公司毛利率水平出现波动。此外，公司的产品规格数量较多，不同规格的

产品销售结构的变化亦会对公司的毛利率造成影响。

3.固定资产建设投资风险

集成电路行业是典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高。为了紧抓行业发展机遇、满足客户需求、提高市场竞争力，公司积极进行产能扩充，固定资产投资规模较大。虽然公司统筹制定了固定资产建设规划与资金筹措安排，但在实际建设过程中，受宏观经济形势、融资市场环境变化等不可控因素影响，公司可能面临一定的资金压力；另外，随着大额固定资产的增加，折旧费用也将相应上升，若公司未来产销规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，公司将面临盈利能力下降的风险。

4.存货跌价风险

报告期末，公司的存货账面价值为 138,625.65 万元，占总资产比例为 2.87%；存货跌价准备金额为 3,396.29 万元，对应存货期末余额的计提比例为 2.39%，较 2023 年末存货跌价准备对应存货期末余额计提比例 6.38%已有所下降。公司根据已有客户订单需求以及对未来市场需求的判断制定采购和生产计划，若未来市场环境发生变化、竞争加剧、产品技术迭代更新，致使公司对市场需求的预测出现偏差，客户的订单未来无法执行或延缓提货，使得库存产品滞销、存货积压，可能会导致存货库龄变长、可变现净值降低，公司将面临存货跌价的风险。

（四）行业风险

1.产业政策变化风险

公司所处的集成电路行业是国家重点鼓励发展的领域之一。国家陆续出台了包括《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）等多项产业政策，促进集成电路行业发展；我国各级政府亦为集成电路企业提供了相关政策支持，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予一系列优惠措施，为国内集成电路行业带来了良好的发展机遇，集成电路行业整体的设计能力、生产工艺水平、自主创新能力有了较大的提升。如未来上述产业政策出现不利变化，将对公司的业务发展、人才引进、生产经营产生

一定不利影响。

2.市场竞争加剧风险

近年来，在产业政策和地方政府的推动下，集成电路行业呈现出较快的发展态势，良好的行业前景吸引了更多的新进入者和资金资源。伴随新增产能的释放，市场供给增加，行业竞争日趋激烈。公司经过多年的发展与积累，通过自研工艺的迭代与大量新产品的开发、生产实践，已积累了丰富的产品开发和生产经验，但相较于行业龙头企业，公司在技术先进性、市场竞争力上还有一定差距。未来，如果公司不能正确应对市场竞争，无法及时开发和引进最新的制造工艺技术，或推出能够更好地满足客户需求的工艺平台，公司产品可能会被竞品替代，从而导致公司在市场竞争中处于不利地位。

3.供应链风险

集成电路行业对原材料、零备件、软件和设备等的质量和技术性要求较高，部分重要原材料、零备件、软件、核心设备等在全球范围内的合格供应商数量较少，且大多来自中国境外。公司持续推进关键设备及材料的多元化和自主可控，但如果因为地缘政治等因素，相关国家贸易政策变动，公司重要原材料、零备件、软件、设备等的出口许可、供应、物流受到限制或价格上涨，将可能会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

（五）宏观环境风险

1.国际贸易摩擦风险

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护、技术限制的手段，对我国相关产业的发展造成了一定程度的负面影响。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦贸易政策、关税、出口限制、其他贸易壁垒进一步恶化，或导致公司业务受限、公司采购范围受限，将会对公司的正常生产经营产生不利影响。

2.宏观经济波动和行业周期性风险

目前，全球半导体市场承压，半导体产业仍处于周期性波动中。公司主要从事集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售，属于集成电路行业的中游环节，

具有较强的周期性，并且与下游行业及宏观经济周期密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，消费电子领域市场规模将受到较强的冲击，终端销量的下滑也将让下游客户在备货策略上更为保守，从而导致需求下降，包括公司在内的集成电路企业将面临一定的行业波动风险，对经营情况造成不利影响。

四、重大违规事项

2024 年上半年度持续督导期间，晶合集成不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年 1-6 月，晶合集成主要会计数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	本报告期比上年同期变动(%)
营业收入	4,397,777,256.70	2,969,665,910.58	48.09
归属于上市公司股东的净利润	187,002,537.88	-43,610,155.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,674,882.94	-146,197,879.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,295,165,395.36	-298,782,383.33	不适用
主要会计数据	2024 年 6 月末	2023 年末	本报告期比上年末变动(%)
归属于上市公司股东的净资产	20,954,856,173.95	21,409,804,721.09	-2.12
总资产	48,316,042,828.99	48,156,279,600.77	0.33

2024 年 1-6 月，晶合集成主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本报告期比上年同期变动
基本每股收益（元 / 股）	0.10	-0.03	增加 0.13 元/股
稀释每股收益（元 / 股）	0.10	-0.03	增加 0.13 元/股
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.05	-0.09	增加 0.14 元/股
加权平均净资产收益率（%）	0.86	-0.27	增加1.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.44	-0.89	增加1.33个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	13.97	16.92	减少2.95个百分点

报告期内，晶合集成上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

营业收入较上年同期增加 142,811.13 万元，同比增长 48.09%，主要系行业景气度逐渐回升，上半年整体销量实现快速增长所致；

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加 23,061.27 万元、24,087.28 万元，主要系报告期内公司营业收入同比增长，以及产能利用率持续提升，单位销货成本下降，产品毛利率提升所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 159,394.78 万元，主要系本报告期营业收入同比增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.10 元/股、0.10 元/股、0.05 元/股，较上年同期分别增加 0.13 元/股、0.13 元/股、0.14 元/股，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发团队经验丰富，技术实力行业领先

公司研发团队核心成员均由境内外资深专家组成，在不同的技术方向具有丰富的研发经验。公司已建立完善、成熟的研发机制，高度重视并持续加强研发团队建设及研发能力提升。公司坚持以行业发展趋势和客户需求为导向，积极探索新的业务领域，确保公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，满足客户终端产品的需求。报告期内，公司研发投入金额达 61,418.25 万元，较上年同期增长 22.27%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有 4,674 名员工，其中研发技术人员 1,620 名，占员工总数比例为 34.66%，其中硕士及以上占比约 62.10%。

通过多年持续的研发投入，公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共取得专利 878 个，其中发明专利 694 个、实用新型专利 184 个。

（二）产品结构不断丰富，工艺平台多元发展

公司已实现 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic 等工艺平台量产，产品结构日益多样化，产品应用涵盖智能手机、电脑、平板显示、汽车电子、智能家用电器、工

业控制、物联网等诸多领域。报告期内，公司不断推出有市场竞争力的新产品，进一步优化了产品结构。其中，40nm 高压 OLED 显示驱动芯片已实现小批量生产；55nm 中高阶 BSI 及堆栈式 CIS 芯片实现大批量生产，CIS 产品像素可达到 5000 万，产品已进入中高阶手机市场。

（三）位居合肥战略核心，产业链协同效应强

公司地处国家级科技创新型试点城市合肥市。合肥市基于集成电路产业发展规划，结合自身特色提出了“芯屏汽合”的产业发展战略，已形成新型显示器件、集成电路、新能源汽车和人工智能等新兴产业，终端芯片需求旺盛。公司所处的代工环节为半导体产业链中最为重要的环节之一。公司充分发挥本地终端市场距离近、规模大的优势，依靠成熟制程制造经验，服务于合肥产业链规划，提供关键芯片，促进产业链协同联动发展。

（四）客户关系紧密持久，推动国产供应替代

公司与众多客户建立了长期、紧密的合作关系，获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可，客户群体覆盖部分国际一线公司。公司在业界具有良好的口碑及供应商基础，最大程度地采用国产化设备与材料，保证供应链安全，推动国产供应替代。

（五）体系认证齐全，质量稳定可靠

公司建立了完善的质量管理体系，依托产品研发及工艺技术的综合实力保证并提升产品品质。截至目前,公司已取得质量管理体系认证 ISO9001，环境管理体系认证 ISO14001，职业健康安全管理体系认证 ISO45001，有害物质过程管理体系 QC080000，温室气体排放盘查认证 ISO14064 等诸多认证。此外，在车用芯片领域，公司已取得车载质量管理体系 IATF16949 认证。

（六）智能制造，高效稳定，成本具有竞争力

公司智能生产线拥有高端智能制造营运管理制度及系统，涵盖数字化生产系统、自动化无人搬运系统、车间自动化控制系统、智能品质与设备监控系统、智能生产派工系统等，可为客户提供更优质代工服务及更稳定的产品品质。公司持续深耕本地产业链配套，积极推动关键原辅材料和设备的国产化，加大国产替代力度，从原

材料到整机产业链，可实现就近供应，且最大程度地采用国产化设备与材料，产品成本更具竞争力。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

单位：元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	本报告期比上年同期变动(%)
费用化研发投入	614,182,514.17	502,330,825.33	22.27
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	614,182,514.17	502,330,825.33	22.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.97	16.92	减少 2.95 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	/	/	/

（二）研发进展

公司始终高度重视产品研发，持续加大研发投入，聚焦核心技术，紧跟传统领域与新兴市场的发展趋势，规划和研发更丰富的工艺平台，持续推进成熟制程先进节点的发展。

报告期内，公司研发费用投入 61,418.25 万元，较上年同期增长 22.27%，占公司营业收入的 13.97%，新获得发明专利 151 项、实用新型专利 36 项。报告期末公司共有员工 4,674 人，其中研发人员 1,620 人，占比 34.66%。

报告期内，公司研发进展顺利，取得了显著的成果，新产品逐步导入市场，如 55nm 中高阶 BSI 及堆栈式 CIS 芯片工艺平台实现大批量生产、40nm 高压 OLED 显示驱动芯片实现小批量生产、新一代 110nm 加强型微控制器平台（110nm 嵌入式 flash）完成开发等，进一步提升市场竞争力。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,533,789股。公司每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099号）。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91
加：未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税）	2,431,486.99
加：利息收入扣除银行手续费净额	95,515,323.95
减：募集资金投资项目支出(a+b+c)	7,299,268,969.81
其中：直接投入募集资金项目的金额(a)	4,813,840,335.58
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b)	2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)	410,204,079.82
减：节余资金永久补充流动资金	344,436,563.93
减：超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减：超募资金回购公司股份	164,520,697.56
减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金	0.00
截至2024年6月30日募集资金专户应有余额(d)	1,953,237,039.55
截至2024年6月30日募集资金专户实际余额(e)	1,953,237,039.55
差异(d-e)	0.00

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额	备注
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057	594,433,232.39	
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	619,807,008.33	

银行名称	银行账号	余额	备注
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	736,565,312.64	
招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	0.00	2024年7月17日已销户
兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行	499050100100419345	0.00	2024年7月19日已销户
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	0.00	2024年5月17日已销户
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	2,431,486.19	
合计		1,953,237,039.55	/

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，募投项目“后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含90纳米及55纳米）”、“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”达到预定可使用状态日期分别延期至2024年底、2025年中。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币20亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,214,240,240.72元，均为协定存款。此外，报告期内公司购买的收益凭证全部已赎回。

（二）募集资金合规情况

公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，晶合集成现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动的情况如下：

姓名	职务	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	报告期内股份 增减变动量 (股)	增减变动原因
吴志楠（离任）	助理	0	5,000	5,000	二级市场买入

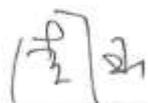
截至 2024 年 6 月 30 日，晶合集成控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，公司不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



周 玉



李义刚



2024年 8 月 13 日